

Recursos e benefícios

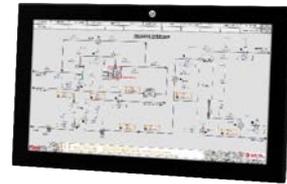
- Disponível em tamanhos de tela de 12,1" a 24"
- Resoluções incluem FHD / SXGA / XGA / WXGA
- Disponível nas molduras de perfil padrão ou baixo
- As unidades de moldura em alumínio e vidro são compatíveis com diversas resoluções, incluindo telas de alta definição
- Unidades de perfil baixo estão disponíveis com as seguintes variações de moldura
 - Alumínio
 - Alumínio com vidro plano
 - Widescreen de aço inoxidável IP69K (análogo resistivo) com gaxeta de grau alimentício azul substituível
- Tela resistiva analógica e capacitiva projetada (para operação multitoque)
- Quatro portas Ethernet de 10/100/1000 Mbps
- Oferece suporte aos padrões de rede "Jumbo Frame" e "Wake on LAN"
- Disponível com Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Variações disponíveis com suporte de longa distância para até duas telas adicionais
- Tipos de armazenamento em massa de até 1 TB que incluem mSATA, SSD SATA III e CFAST (até 128 GB)
- Até 32 GB de RAM DDR4 SODIMM
- Variações de USB de 1x USB 2.0 (Tipo A) dianteiro e traseiro e até 3x USB 3.0 traseiro (Tipo A)
- 1x porta serial RS-232 (DB9M)
- 1x saída de vídeo DVI-D
- IP65/IP69K (dependente do modelo)
- Construção sem ventilador
- Opções adicionais em TPM, slots de expansão PCI, comunicação adicional
- Alimentação isolada de 24 Vcc (18 a 32 Vcc)
- Temperatura em operação de 0 °C a 50 °C
- CE, listado pela c-UL-us (61010), RCM Approvals
- Projeto compatível com ThinManager®



PC de painel 6300P em aço inoxidável



Junta de grau alimentício



PC de painel 6300P de perfil baixo (frente)



PC de painel 6300P de perfil baixo (traseira)

O ASEM™ 6300 é um portfólio completo de thin clients, monitores e PCs industriais de arquitetura aberta. Essa linha ampla e adaptável oferece a flexibilidade necessária para atender aos seus requisitos específicos de desempenho.

O PC de painel ASEM 6300P é baseado nos processadores Core i3, i5 e i7 de 7ª Geração da plataforma Intel Kaby Lake H e no Intel Celeron do Skylake, o que permite que ele lide com aplicações industriais complexas. Eles possuem telas touchscreen resistiva analógica de um toque ou capacitiva projetada multi-toque (PCAP) para aprimoramento da produtividade do operador. Estes poderosos PCs de painel estão disponíveis com uma variedade de tamanhos de tela e resolução, com opções de moldura padrão ou de perfil baixo. Unidades PCAP podem ser solicitadas com painel frontal sem marca. Ambas apresentam resolução até Full HD.

O grau de proteção IP65/IP66/IP69K (dependente do modelo) torna o PC de painel ASEM 6300P um par perfeito para aplicações de jato de líquido como processamento de alimentos e ciências da vida. A construção sem ventilador ajuda a garantir operação de baixa manutenção e aprimora a longevidade.

O PC de painel ASEM 6300P pode ser solicitado com Windows IoT Enterprise 2019 LTSC ou sem sistema operacional para permitir que o usuário utilize seu próprio sistema. Ele é equipado com uma placa-mãe "all in one" para oferecer confiabilidade em ambientes sujeitos a choques e vibrações. Inclui quatro portas Ethernet e oferece suporte aos padrões de rede "Jumbo Frame" e "Wake on LAN", facilitando sua incorporação aos sistemas já existentes.

Ambientes de chão de fábrica são exigentes. Os PCs de painel ASEM são uma combinação sólida para aplicações que exigem uma interface homem-máquina (IHM) de alto desempenho. Essa família de produtos integra-se completamente aos nossos softwares FactoryTalk® View SE e FactoryTalk View ME para assimilação perfeita nas suas instalações. O portfólio tem diversas opções de design disponíveis, tornando essa família de produtos robusta uma ótima opção para ambientes de chão de fábrica.

PC de painel ASEM 6300P

	Moldura de alumínio padrão	Moldura de alumínio de perfil baixo e alumínio com vidro plano
TFT LCD com LED de iluminação	12,1" - 1024x768* 15,0" - 1024x768 17" - 1280x1024 19" - 1280x1024	12,1" W - 1280x800 - Aço inoxidável 15,6" W - 1920x1080 18,5" W - 1920x1080 21,5" W - 1920x1080 24" W - 1920x1080
Tela touchscreen	Resistiva analógica	Alumínio com vidro plano P-CAP multitoque ou resistiva analógica - Alumínio
Grau de proteção	Moldura em alumínio - IP65 / IP66 (dependente do modelo) - Moldura de aço inoxidável - IP69K	
Processador (Moldura em aço inoxidável disponível apenas com processador i5)	Intel Celeron G3900E de 2,40 GHz, 2 núcleos/2 threads, cache L2 de 2 MB, soldado Intel Core i3-7100E de 2,9 GHz, 2 núcleos/4 threads, cache inteligente de 3 MB, soldado Intel Core i5-7440EQ de 2,90 GHz (3,60 GHz Turbo), cache inteligente de 6 MB, 4 núcleos - 4 threads Intel Core i7-7820EQ de 3 GHz (3,7 GHz Turbo), 4 núcleos/8 threads, cache inteligente de 8 MB	
Chipset	PCH (hub do controlador da plataforma) do Intel HM170 PCH (hub do controlador da plataforma) do Intel HM175 - Incluído no chip do processador	
Controlador de vídeos	Intel HD Graphics 510 integrado ao microprocessador Intel Celeron, 950 MHz Intel HD Graphics 630 integrado ao i3-7100E, relógio de 350/950 MHz Intel HD Graphics 630 integrado ao i5-7440EQ/i7-7820EQ, relógio de 350 MHz/1 GHz	
Memória do sistema - RAM	4 GB/8 GB/16 GB/32 GB (2 módulos SODIMM DDR4-2400) Moldura de aço inoxidável disponível apenas com 8 GB	
Armazenamento em massa	1x slot inicializável de até 128 GB CFast SATA III integrado com acesso frontal externo 1x conector integrado para inserção direta de mSATA até SSD SATA III de 1 TB 1x conector integrado para SSD SATA III de 2,5" até 1 TB	
Rede local	4 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 - 3 x Intel I210, 1 x Intel I219-LM) Moldura de aço inoxidável - 3 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 - 3 x Intel I210, 1 x Intel I219-LM)	
USB (Número de portas USB depende do modelo)	3 x USB 3.0 traseiro (Tipo A) 2 x USB 2.0 traseiro (Tipo A) 1 x USB 2.0 dianteiro (Tipo A)	3x USB 3.0 traseiro (Tipo A) 2x USB 2.0 traseiro (Tipo A)
Serial	1x RS232 (DB9M)	
Saída de vídeo	1x DVI-D	
Slots de expansão	1x PCIe x4 (5 Gb/s)	
Energia	Alimentação isolada de 24 Vcc (18 a 32 Vcc)	
Sistema operacional certificado	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit	
Temperatura em operação	Temperatura em operação de 0 °C a 50 °C com o processador Celeron/Core i3; 0 °C a 45 °C com o processador Core i7	
Aprovações	CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), LISTADO pelo cULus (UL61010), RCM	

Connect with us.    

rockwellautomation.com — expanding human possibility®

AMÉRICAS: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 EUA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
EUROPA/ORIENTE MÉDIO/ÁFRICA: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Bélgica, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
ÁSIA-PACÍFICO: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846
BRASIL: Rockwell Automation do Brasil Ltda., Rua Verbo Divino, 1488 - 1º andar, Chac. Sto Antonio, 04719-904, São Paulo, SP, Tel: (55 11) 5189-9500,
www.rockwellautomation.com.br
PORTUGAL: Rockwell Automação, Lda., Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Edifício Ciência II, n.º 11 - 2ºC, Taguspark, Porto Salvo 2740-120, Tel.: (351) 214 225 500,
www.rockwellautomation.com.pt

Allen-Bradley, ASEM, expanding human possibility, FactoryTalk, Rockwell Automation e ThinManager são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation.

As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Publicação 6300P-PP001D-PT-P - Dezembro 2021 | Substitui a publicação 6300P-PP001C-PT-P - Novembro de 2020

Copyright © 2021 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.